



平成 30 年 5 月 1 日

各 位

会 社 名 大阪有機化学工業株式会社
代 表 者 代表取締役社長 上林 泰二
(コード番号:4187 東証第一部)
問合せ先 取締役執行役員管理本部長
本田 宗一
TEL 06-6264-5071(代表)

半導体関連材料の新規設備建設等に関するお知らせ

当社は下記の通り、金沢工場(石川県白山市)における新規設備建設等が決定しましたのでお知らせいたします。

記

1. 新規設備建設計画の概要

対象商品	半導体関連材料
所在地	石川県白山市松本町 1600-1
着工予定	2018 年 5 月
完成予定	2019 年 3 月
操業開始予定	2019 年 6 月
設備投資額	約 20 億円

※上記の設備以外に、半導体関連材料の研究開発・製品分析のための分析装置購入や研究棟の増築工事を計画しております。

2. 目的

半導体関連材料の需要は拡大が見込まれます。今回の新規設備建設は、中長期的に見込まれる半導体の市場需要に対応することを目的としております。

3. 今後の見通し

本設備投資が当期の連結業績に与える影響は軽微です。今後開示すべき事象が発生した場合は速やかにお知らせいたします。

以上